**2025年度普陀区集成电路产业专项申报指南**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **板块** | **编号** | **资助事项** | **项目支持类型** | **支持标准和方式** | **申报条件** | **申报材料** |
| 产业集聚培育 | A1 | 鼓励优质企业落户 | 事前立项分阶段支持 | 给予最高不超过500万的开办费资助。分三年拨付。 | 1、申请主体新注册并纳税在普陀区内，主营业务属于汽车芯片、人工智能芯片、嵌入式CPU、高算力芯片、其他高端芯片、EDA设计工具、高端电子元器件及印制电路板、智能模组、智能终端等重点技术领域，具有一定研发投入、创新水平和规模增速。2、登记日期在2024年1月1日后。3、在引进落地阶段经普陀区科委入库。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、所在重点地区推荐函。 |
| A2 | 降低企业经营成本 | 事后一次性支持 | 根据实际租赁自用面积，年度资助金额不超过100万元，事后一次性拨付。 | 1、申报主体为2024年1月1日之后在本区新引进、新设立，注册地、税管地和经营地均在普陀区。2、企业具有一定研发投入、创新水平和规模增速。3、在引进落地阶段经普陀区科委入库。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、所在重点地区推荐函。3、2024年度办公场所租赁协议或合同。4、连续3个月及以上租金支付凭证。 |
| A3 | 事前立项分阶段支持 | 对新引进企业在区内新购置自用办公用房的，按新购房款的1.5%给予资助，总额不超过300万元。分三年拨付。 | 1、申报主体为2024年1月1日之后在本区新引进、新设立，注册地、税管地和经营地均在普陀区。2、企业实际购置自用办公用房面积1000平方米以上。3、具有一定研发投入、创新水平和规模增速。4、在引进落地阶段经普陀区科委入库。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、所在重点地区推荐函。3、办公用房购买协议或合同。4、购房发票及支付凭证。 |
| 产业集聚培育 | A4 | 鼓励“以企引企” | 事后一次性支持 | 集成电路企业采用参股方式新设或迁移引进产业链上下游关联企业，且企业注册一年内参股资本超100万元的，经认定，可按其实际投入金额的10%以内比例，给予最高不超过50万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、对新注册企业参股超100万元。3、新企业注册日期在2024年1月1日后。4、在引进落地阶段经普陀区科委入库。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、参股合同或协议。3、申报企业实际投入明细、付款凭证及相关票据。 |
| A5 | 培育初创企业 | 事后一次性支持 | 成立五年以内的集成电路设计企业，成功获得专业投资机构投资并在一年内提出申请的，可按投资金额最高的单个非政府性质的专业投资机构实际到位股权投资资金的10%以内比例，给予最高不超过300万元的一次性资助。本条款专项用于初创期优质企业扶持。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构，且成立日期在2020年1月1日后。2、申请主体融资到账时间在2024年1月1日后。3、申请主体为初创企业，营收规模不高于2亿元。4、投资机构须在中国证券投资基金业协会备案,或经营范围含股权投资、创业投资、股权投资管理、创业投资管理,以国家市场监督管理部门核发的营业执照为准。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、投融资合同、协议等相关证明材料。3、企业投融资资金到账证明。4、投资机构相关资质证明（营业执照、信用等级等）。 |
| 产业创新发展 | B1 | 支持EDA/IP购买 | 事后一次性支持 | 对购买符合条件的自主安全可控EDA设计工具软件、购买国产自研IP进行高端芯片研发的企业或平台，可按实际支付费用的50%以内比例，给予每家企业或平台每年最高不超过200万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、产品交付时间为2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、产品版图复印件（附IP位置标注）或正版EDA软件相关证明。3、EDA或IP购置明细、采购合同、财务凭证、发票等。 |
| B2 | 支持企业流片 | 事后一次性支持 | 对于使用多项目晶圆（MPW）流片进行研发的企业，给予MPW直接费用最高40%的资助，每家企业年度资助总额不超过200万元。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、费用发生在2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、MPW相关费用支出明细、与相关企业签订的多项目晶圆（MPW）合同、财务凭证、发票等。3、产品的知识产权证书（布图登记证书或与之相关的发明专利）。 |
| B3 | 事后一次性支持 | 对于首次完成全掩膜（Full Mask）工程产品流片的企业，可按流片费用的40%以内比例，给予每家企业每年总额最高不超过300万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、费用发生在2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、相关费用支出明细、与相关企业签订的工程流片合同、财务凭证、发票等。3、产品的知识产权证书（布图登记证书或与之相关的发明专利）。 |
| B4 | 支持开展工程样片测试验证 | 事后一次性支持 | 对开展工程样片的功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析等方面的测试验证及相关认证的集成电路设计企业，可按实际发生费用的50%以内比例，给予每年最高不超过200万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、费用发生在2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、开展工程样片功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析等方面测试验证及相关认证的文件（不包含量产测试）。3、相关费用支出明细、测试合同、发票等。4、测试机构出具的测试结果报告，包括测试数量、测试项目、性能指标等内容。 |
| 产业创新发展 | B5 | 支持开展车规认证 | 事后一次性支持 | 经认定，按照培训和认证费实际发生额的50%给予补贴，可补贴两年，每年最高不超过100万元。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、企业开展AEC-Q100（IC）、AEC-Q101（分立器件）、AEC-Q102（光电器件）、AEC-Q103（MEMS传感器）、AEC-Q104（多芯片模组）、AEC-Q200（被动组件）可靠度标准认证。3、企业开展ISO 26262功能安全标准、IATF16949体系的培训与认证。4、费用发生在2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、企业开展车规体系培训与认证的合同及发票。3、车规体系认证通过证明材料。 |
| B6 | 支持成果研发转化 | 事前立项分阶段支持 | 鼓励企业或机构自主开展或联合上下游产业链企业、科研平台、院所高校等开展产学研合作并实施产业化项目，经认定，可按项目实际投入资金总额的30%以内比例，给予最高不超过300万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构。2、研发成果具有自主知识产权，符合本区产业导向并在区内实施产业化，产业化目标明确。3、项目投入包括：建设经费（机房建设费、硬件设备购置费、软件购置或开发费、托管租赁费、测试化验加工费等）；运营经费（材料费、劳务费、专家咨询费、协作研究费、知识产权费等）。4、项目执行周期在2025年1月1日-2026年12月31日期间。5、本项目采取事前立项验收后拨付方式进行支持，项目执行期不超过两年，企业应具备落实项目总投入资金的能力，并在立项后先行投入。 | 1、申报单位营业执照复印件2、项目自筹资金来源证明。3、联合高校、科研院所、功能型平台开展产学研合作的，需提供合作协议。4、项目相关知识产权证明或查新报告。5、创新成果产业化目标和计划。 |
| 产业生态打造 | C1 | 支持公共服务平台建设 | 事后一次性支持 | 对为集成电路企业提供技术研发、技术咨询、检验检测、测试认证、成果对接、技术交易等服务的公共服务平台，经认定，可按实际投资金额的30%以内比例，给予最高不超过200万元的一次性资助。对公共服务平台服务集成电路企业的，经认定，可按服务合同实际完成金额的10%以内比例，给予平台每年最高不超过100万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的服务于集成电路企业的公共服务平台。2、取得集成电路领域相关服务资质，自筹资金投入平台软硬件建设达到500万元（含）以上，且用户数量不少于10家。3、优先支持获得国家、上海市认定的产业技术基础公共服务平台、专业技术服务平台等。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、完成平台建设和投入使用证明，包含平台服务资质证明、服务用户数量及明细、用户合同、技术合同登记编号和支付凭证复印件等。3、国家级或市级相关认定证明文件。 |
| C2 | 鼓励产业集聚发展 | 事后一次性支持 | 对下游应用端企业首购首用非关联集成电路设计企业的自主开发芯片或模组的，可按年度实际采购金额的20%以内比例，给予每家企业每年最高不超过50万元的资助。对集成电路设计企业首购首用集成电路相关配套产业（包括智能软件等）非关联企业的产品和服务，可按年度实际采购金额的20%以内比例，给予每家企业每年最高不超过30万元的资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路领域企业或机构、集成电路下游应用端企业或机构。2、采购款支付时间在2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、采购方与被采购方无关联关系的承诺函。3、采购合同及付款凭证、发票。 |
| 产业生态打造 | C3 | 支持行业合作交流 | 事后一次性支持 | 对主办或承办相关领域具有一定影响力的峰会、论坛、展览会、博览会等活动，具有示范带动效应且促进区域产业集聚的，经认定，可按投入资金总额的50%以内比例，给予最高不超过200万元资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路产业领域企业或机构，且有一定科技创新能力。2、主办或承办相关领域具有一定影响力的峰会、论坛、展览会、博览会等活动，具有示范带动效应且促进区域产业集聚的。3、所主办或承办活动应事前向普陀区科委申报。4、投入资金包括：场地费、新闻媒体费、物料费、运输费、搭建费等。5、活动在2024年1月1日至2024年12月31日期间。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、委托实施活动的材料，相关部门同意举办活动证明3、展会或论坛活动总体方案(包括拟邀请的单位等)。4、活动总结、经费决算审计报告等。5、活动招商成果总结及落地企业清单等佐证材料。6、活动现场照片、媒体报道证明。 |
| C4 | 事后一次性支持 | 对组织相关领域具有一定影响力的联盟、协会等，具有示范带动效应且促进区域产业集聚的，经认定，可按投入资金总额的50%以内比例，给予最高不超过200万元资助。 | 1、申请主体为新注册在普陀区内的集成电路产业领域行业协会、联盟等运营机构，注册地、运营地和税管地均在普陀。2、运营机构在引进落地阶段经普陀区科委入库。 | 1、企业营业执照或民办非企业单位登记证书复印件。2、场地租赁证明及运营情况说明。3、专项审计报告。 |
| C5 | 事后一次性支持 | 对参与具有影响力的相关产业峰会、论坛、展览会等活动，经认定，对参展单位每次按活动实际发生的注册费、展位费、搭建费等给予50%以内比例，最高不超过50万元资助。 | 1、申请主体为注册并纳税在普陀区内的集成电路产业领域企业或机构，且有一定科技创新能力。2、参与具有国内外影响力的相关产业峰会、论坛、展览会等活动。3、参展费包括注册费、展位费、搭建费、展品运输费、企业工作人员往返交通费（不超过2人，每人最高补贴5000元）等。4、活动在2024年1月1日至2024年12月31日期间举办。 | 1、申报单位营业执照复印件。2、所参与活动对产业影响力的情况介绍。3、申报单位活动方案、参展合同及参展成果。4、申报单位活动现场照片、媒体报道。5、专项审计报告（活动费用10万以上须提供）。 |